PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-141986

(43) Date of publication of application: 02.09.1982

(51)Int.CI.

H01S 3/18 H01L 23/36

(21)Application number: 56-026543

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

25.02.1981

(72)Inventor: MURAKAWA KYOHEI

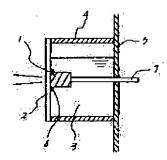
OGAWA SEIYA OGAWA KOICHI YOKOUCHI KISHIO NIWA KOICHI

(54) COOLING METHOD FOR SEMICONDUCTOR LASER

(57)Abstract:

PURPOSE: To elongate the life of the semiconductor laser by directly immersing a semiconductor laser chip or a package containing a chip in inactive, noncombustible or fire retardant cooling liquid, and cooling the chip highly efficiently.

CONSTITUTION: A light transmitting glass wall 2 is provided on the open side of the package 4, the semiconductor laser chip 1 is fixed to the inside of the wall 2 by using a sealing material 6. An optical fiber 7 which monitors the back surface and controls the output of the chip 1, is attached to the back surface of the chip. Then the other end of the optical fiber 7 is protruded to the outside, and a heat radiating plate 5 is attached to the package 5. The cooling liquid 3 of a CNF2N+2(N=4 \sim 7) chain compound which is a fluorocarbon series compound that does not include a C-OH group, a C=O group, or a C=C group is enclosed in the package 4. At this time, the liquid 3 is not completely enclosed and a space is left in the upper part, so that



the space is filled up with the vapor of said liquid. The condensating heat, which is generated when the vapor is condensed and returned to the liquid, is irradiated from the outer wall.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁 (JP)

10 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭57—141986

f)Int. Cl.³
 H 01 S 3/18
 H 01 L 23/36

識別記号

庁内整理番号 7377--5F 6426--5F 砂公開 昭和57年(1982)9月2日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

郊半導体レーザの冷却方法

願 昭56-26543

②出 願 昭56(1981) 2 月25日

@発 明 者 村川恭平

②特

23

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

@発 明 者 小川清也

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑫発 明 者 小川紘一

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑫発 明 者 横内貴志男

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑫発 明 者 丹羽紘一

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

個代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

男 細 署

1. 発明の名称 半導体レーザの冷却方法

2. 特許請求の範囲

- (1) 半導体レーザチョブ政は半導体レーザチョブ を収容したパッケージを不活性且つ不知もしく は転燃性の冷却用液体中に直接浸漬することを 特徴とする半導体レーザの冷却方法。
- (2) 前配冷却用液体がC-OH差、C=O基、 C=C基のいずれをも含まないフルオロカーボン系の化合物であることを特徴とする特許請求の範囲第1項配載の半導体レーザの冷却方法。
- (3) fi配CONH 蒸、C=O 蒸、C=C 蒸のいずれをも含まないルオロカーボン系の化合物がれてnF_{2n+2}(コ=4,5,6又は7)で表わさたる値状化合物であるととを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の半導体レーザの冷却方法。
- (4) 半導体レーザチェブを収容するパッケージ内 に前配冷却用液体を封入することを特徴とする 特許請求の範囲線1項配載の半導体レーザの冷

却方法。

- (5) 前配給却用液体を、一度前配半導体レーザの 没債を行なり容器外に導出し、該容器外部に於 て該給却用液体を冷却した後、再び前配容器内 に逃流せしめることを特徴とする特許請求の範 組第1項配載の半導体レーザの冷却方法。
- 3. 発労の詳細な説明

本発明は半導体レーザを被体によって冷却する 方法に関するものである。

半導体レーザは出力の動詞が容易でレスポンス が迷いという特徴を有しており、光通信その他多 方面に利用されているが、光ディスク装置の書込 / 試出し用光麗としても、その制例性や装置を小 型化する上での利点の故に利用が強く望まれてい る。

一万光ディスク装置の省込光線用レーザの具備 すべき条件として、幾何学的に配録密度を高める 為、被長は900mm以下、高速省込の為に出力は 少くとも15mW以上できれば25mW以上である ことが要求される。 FP04-0488-00WO-HP Search Report(2005/6/14) 1/5 GaAlAs 系のレーザは発光波長800 n m 或は

それ以下であるから、放長条件は満すが、出力に 関してはとのような高出力で使用する場合の寿命 は高々1,000時間であって、実用に耐える迄に 至っていたいというのが現状である。

なお、書込用にとのような高出力が必要なのは ガラス板に被増した金属薄膜を短時間のうちに放 発除去しなければならず、その速度として毎秒 10メガビット或はそれ以上が要求されるからで ある。また、書込用に半導体レーザを用いれば、 読出用にはその出力を抑えて使用できるという利 点もある。

半導体レーザに於て出力を上げると寿命が短く なるのは、出力の増加に伴って半導体結晶内の活 性領域の態度が上昇し、結晶の劣化が加速される ととが主たる原因の1つであると考えられている。 従って放熱が最の改響により長寿命化が実現する が、通常半導体レーザチップをヒートシックであ るステムに貼付しただけの場合に比べて、これに 放熱板を設けたものはその出力或は寿命が1桁上 ると言われている。

本発明はかかる見地から、半導体レーザの放射を効率よく行なってその出力或は対命を改善するととを目的とし、その目的の為に利用し得る効果的な冷却在を提供するものであって、半導体レーザテップ或は半導体レーザテップを収容したパッケージを不活性且つ不燃もしくは群繁性の冷却用液体中に直接浸漬することを特徴としている。

最初に本発明に使用する冷却用液体について設明すると、該価体は半導体チャプやバッケージ、リードの特に直接触れるものであるから化学的に不活性であることが要求されるが、その他に冷却剤としての性質上或は取扱答品という点から不然性或は少くも難燃性であることも要求される。また、リード線との接触を考えれば発験性も要求される。

更に、被冷却体が発光率子であることから光学的特性に関しても条件が付く。即ち、冷却装置の 構造上、冷却用液体が光路上に存在する場合もあ るわけで、取扱り被長の光の吸収が小であること

が要求されるのである。

本発明の主な目的である800nm帯の発光案子の冷却という点に着目した場合、C4F10, CsF12, CsF14, C7F18といったフルオロカーボン系の化合物は700~900nm帯の光の戦収が小であり、同時に不活性、不燃性、絶験性であって本発卵の失施によく適合するものである。

本発明を実施する際の装置の形態は指々あるか、 とのフルオロカーボン系の冷却媒体はそのいずれ の形態に於ても最適の材料である。これらのフル オロカーボン系化は物が上配の光学特性を有する のはC-OH、C=O、C=C等の結合を含まめ故 であり、他の系統の化合物で此地の結合を含まず、 不活性、不燃性のものも同様に使用可能である。

次に本発明を実施する冷却装置の形態について 説明する。

本発明の一実施例を第1図のようにレーザチップ1を収容するパッケージも内にを上配CoFiz, 又はCoFiz,等す3を對入して冷却するものである。 レーザーチップ1はその光放出面を透光性ガラス 版2に伝常して固定されており、その背面、上下 面及び 調面が冷却 的液体 3 と接触し、この接触に よってチップ内に発生した熱は冷却用液体に伝わ り液体の一部を気化して脳細な胞を生せしめる。

パッケージに放体を封入する際内部全体を放体 で光填することなく、一部を該液体の深気で充さ れた状態にしておくと、発生した気泡は放中を上 昇しこの空間で外盤と接触し、凝縮して液体にも どる。 この時内壁に生じる凝縮熱は酸パッケージ の外壁を通じて放散される。

このように被体の気化一般磁化よる冷却では多量の気化潜熱が移動する為、単なる伝導や対価化よる熱の移動に比べて冷却効率が良い。上記フルオロカーボン系の化合物は例えば Co Fiz では約30 C. Co Fi4 では約50 C と比較的低い洗点であり、半導体レーザの使用温度付近で蒸発がさかんなのでとのような冷却方式に有用である。

第1 図の装置に於て放熱板 5 はパッケージ外壁 に伝えられた熱を更に外部に放散する為に設けられており、光ファイパ7はレーザの背面出力をモ ニターして出力の制御を行なり為のものである。 が 此等は、ファイバガパッケージを真通する部分の 気密シールを含めて、従来技術の範疇に含まれるものである。

以下の図面に於てはとの光ファイバの表示は省略されているがとれば必要に応じて設けられるべきものである。なお、レーザの励起電流を供給する表示リード語の奏子は全図面で省略されている。

また、第1図の装置ではレーザチップの光放出面はガラス壁に密着し、その周囲はシールされている。これは冷却用液体による放出光の吸収い物質・な力為であり、既述はたような光吸の少い物質・な使用する場合は、第2図のようにレーザチップを被置する為のとなる。との場合、レーザチップを被置する為のステムが必要になる。が、第1図の場合のようにレール材によってガラス面に固定する作業が比較的関鍵であることを考慮すれば、第2図のような構成が可能であることの利点は大きい。これに冷却用

Ř体に前述の物質を使用することによって生する ものである。

第3図はポンプ8を削いて高却用液体を強制値 理させ、外部の放然部9で放然させるもので、装 関が大型化するが冷却効率が向上することは、過 常の発熱器材の令却の場合と同様である。放無部 9の冷却は強制空冷、液冷のいずれでもよいが、 光ディスク表置ではディスクを高速回転させる為、 比較的高速の空気の流れが生じており、これを利 用することによって強制空冷を容易に実施すると とができる。

以上説明したように本発明によれば従来装留に 比べ、俗段に効率よく冷却し得るので半導体レー ザの対命取は出力が大幅に向上する。又、従来光 ディスク装置の高速書込用としてAプチレーザや He - Ne レーザのようなガスレーザが使用されて かり、ガスレーザは装置が大型で助易な取扱いは 型めなかったのであるが、本発明を利用して高出 力の半導体レーザを老込用光能とすることにより、 小型で収扱いの容易な高速配録再生用の光ディス

ク装餌が実現することになる。

4. 図面の態単な説明

第1図乃至第3図は本発明を示す図であって、 1は半導体レーザ、2は透光性ガラス壁、3は冷却用液体、4はパッケージ壁、5は放熱板、6は シール材、7は光ファイバ、8はポンプ、9は外部放熱領域である。

> 代理人 弁理士 松岡 宏四級競 完理 6局十

